

## 後工程一貫(テスト・組立・バックエンド)に関するご提案

- 吉川工業アールエフセミコンとChipMOSの連携により
- 適応領域が広い、BCP対応力の高い水平分業化をご提案
  - Win-Winなパートナーシップを長期レンジで構築
- 御社の製品競争力を大幅に高めるシナジーを実現します！！

2023年12月11日  
吉川工業アールエフセミコン株式会社  
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC.

## 1. テストビジネスモデル

IDM

FabLight

FabLess

Foundry

Design

Design

Design

Design

Fab

Fab

Fab

Fab

WT

WT

WT

WT

Assy

Assy

Assy

Assy

FT

FT

FT

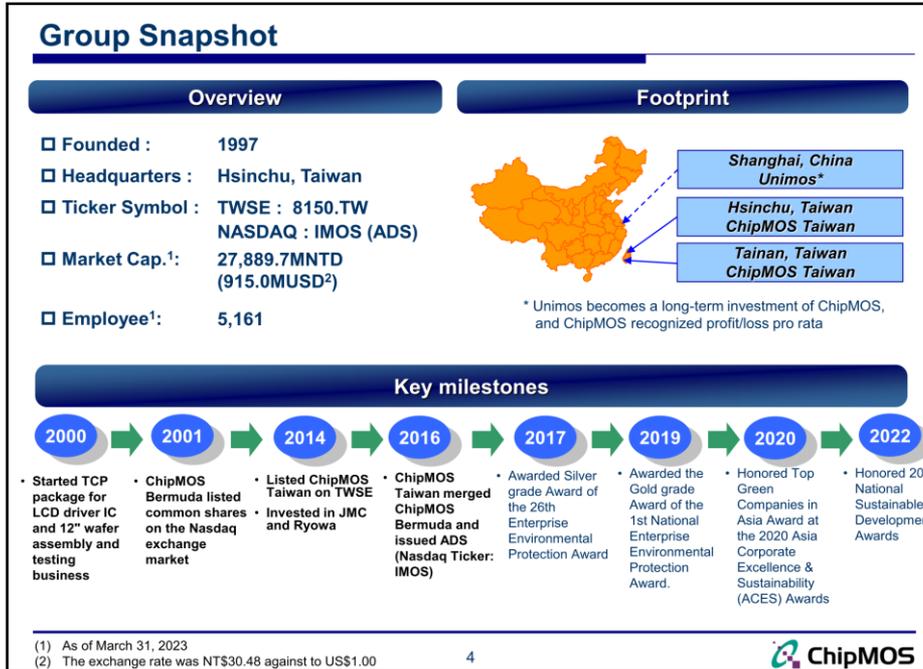
FT

テストサービス &amp; アッセンブリ・テストサービス

&lt;お客様のニーズを解消いたします！&gt;

- ◆ 装置バリエーション、ボリューム、フレキシビリティ → 保有台数は？
- ◆ 生産エリア・拠点 → 国内・海外生産(BCP対応)?、ドロップシップ対応？
- ◆ 品質・技術力 → 安かろう悪かろう×、開発・生産技術力は？
- ◆ コスト競争力 → 高価な装置を購入だけでは×、製造コスト力は？

## 2. CHIPMOS TECHNOLOGIES INC. (ChipMOS)について



- 創立 : 1997年
- 資本金 : NTD 27,889.7 Million
- 拠点(工場) : 新竹(SBIP) : 3拠点  
                  台南 : 2拠点
- 事業内容 : 半導体関連製品群の  
                  後工程サービス
- 主な製品群 : メモリ関連製品  
                  ディスプレイドライバ系製品  
                  Logic & Mixd-Signal系製品

**吉川の強み** : 半導体設計メーカー同等のテスト開発・技術力、日本品質の製造ノウハウ

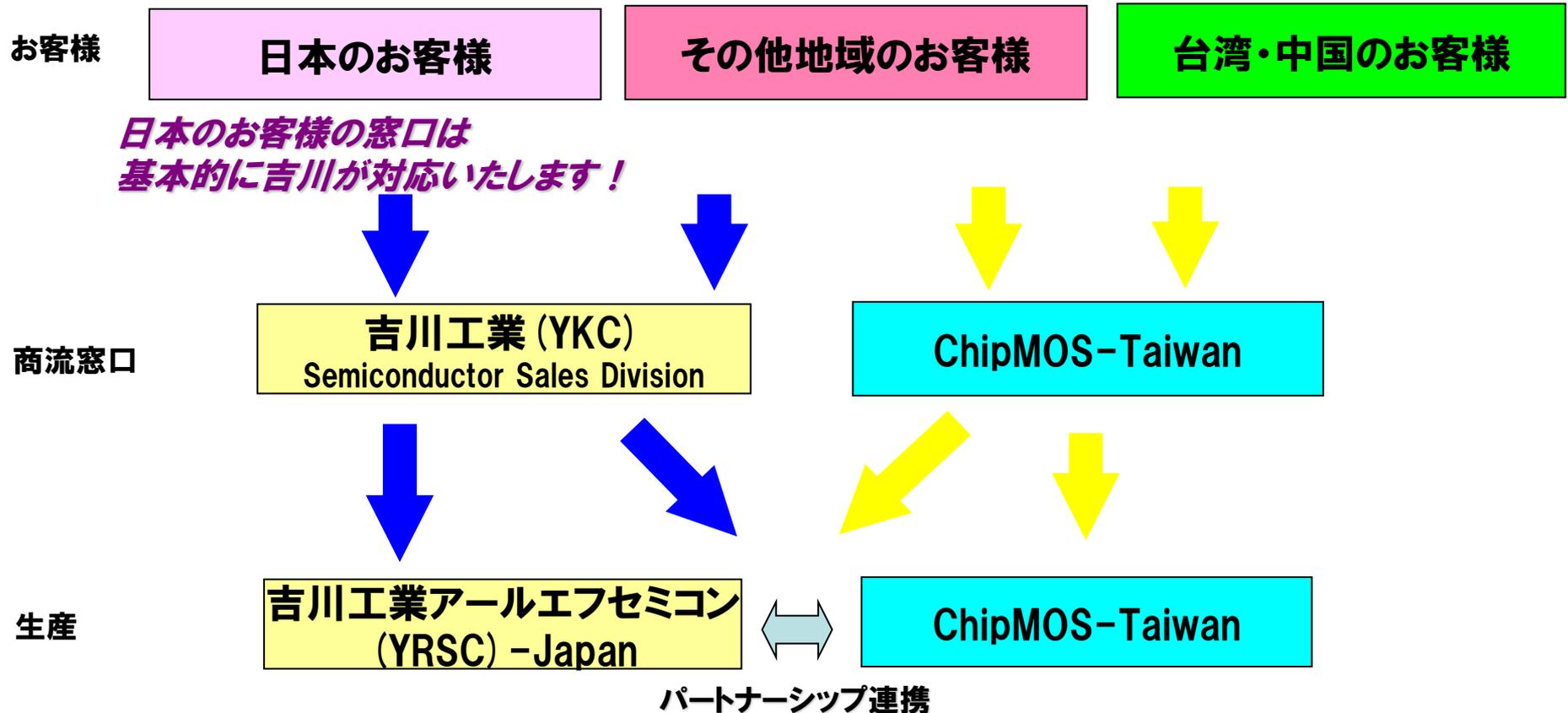
**ChipMOSの強み** : メモリ、ディスプレイドライバ系後工程生産対応力、バラエティーある生産装置  
台湾・海外市場の顧客



**両社の連携によるSynergyをご提供！！**



## 4. 吉川・ChipMOS パートナーシップ連携スキーム



◆ パートナーシップ連携のもと、BCP対応力の高い生産対応を実現します！

# Thank you very much



**吉川・ChipMOSグループとのパートナーシップ連携をご活用ください！！**